



产品描述

专门设计用于数码管的背胶和刷胶工艺和半导体芯片封装等；
具有快速固化特性，适合用于高产率的半导体封装中。

特性

无溶剂，快速固化；
低杂质离子含量；
工作时间长。

胶液性能

固化前性能		测试方法及条件
填料类型	银	-
粘度	18000 cp	Brookfield CP51@5rpm, 25°C
触变指数	3.0	0.5 rpm 粘度/5 rpm 粘度
工作时间	2 周	25°C，粘度增加 25%
贮存时间	1 年	-40°C
固化条件		测试方法及概述
推荐固化条件	10 min@180°C，详情请参考固化曲线（升温曲线改为虚线）	
可选固化条件	6 min@200°C	
固化失重	3.0%	TGA
固化后性能		测试方法及概述
离子含量	氯离子<40 ppm 钠离子<5 ppm 钾离子<5 ppm	萃取水溶液法：5 g 样品/100 筛网，50 g 去离子水，100°C，24 hr
玻璃化转变温度	100°C	TMA 穿刺模式
热膨胀系数	Tg 以下 50 ppm/°C Tg 以上 120 ppm/°C	TMA 膨胀模式
热传导系数	5.0 W/ m • K	激光闪射法，121°C
体积电阻率	< 5×10 ⁻⁴ Ω • cm	4 点探针法
芯片剪切强度	25°C 6200 psi	芯片面积 70 mil ²

上述数据仅可视为产品标准值，不应当作为技术规格使用。

使用说明

运输

在包装和运输过程中该产品保存在干冰（-78℃）中。

拆封

从干冰中取出该产品后应立即放入-40℃的冰箱内，如果反复地回温和再冷冻，容易在针筒类容器内壁产生气泡。

贮藏

该产品建议在-40℃贮藏，在所要求的贮藏条件下可以保证产品的贮藏期限。不恰当的贮藏方法会导致产品加工性能（如：点胶或丝网印刷涂胶）以及固化后性能的降低。

回温

在使用该产品前应先解冻至室温，在解冻时应将针筒或大口瓶竖直放置，在解冻至室温后应先把凝结在容器上的湿气除去后再打开容器。解冻时间请参考解冻温度-时间曲线。

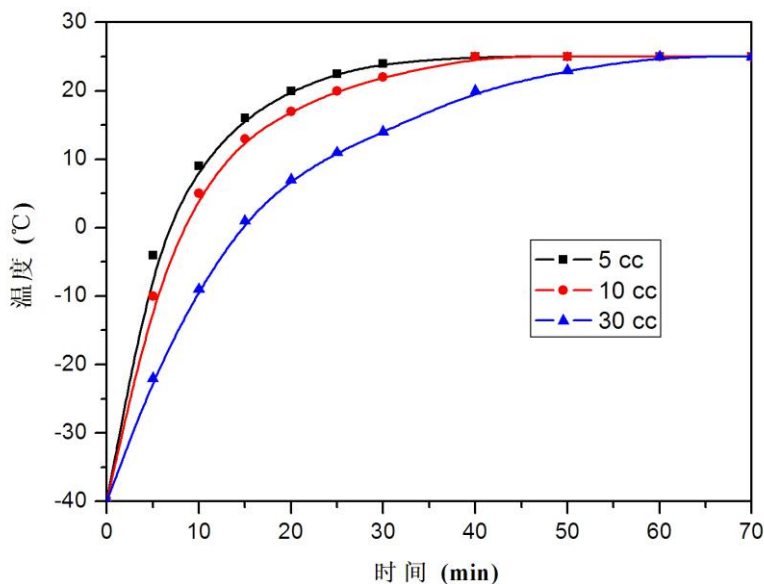


图 1 产品解冻温度-时间曲线

严禁在产品解冻至室温前将容器打开。

不建议二次冷冻使用。

加工使用

回温后的胶应当立即放置到点胶机上备用。如果胶需要转移到后一点胶机上，切忌在转移过程中带入杂质以及空气。该产品必须在推荐的工作时间内使用。详细的使用说明请联系技术服务部。

固化

KM9002HK 胶的全部固化条件建议请查阅 TDS 中的固化条件一栏。固化工艺请参考产品固化曲线。

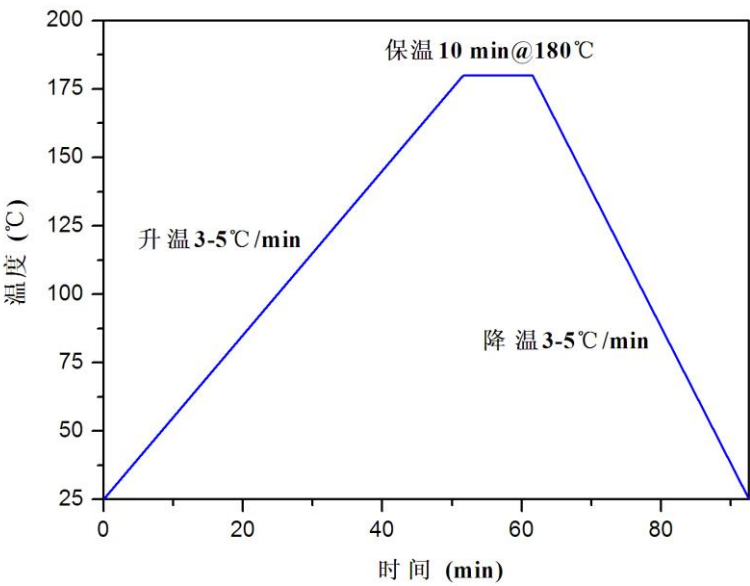


图 2 产品固化曲线

包装形式

KM9002HK系列产品可以按照客户的要求装载于针筒或大口瓶中。包装规格包括 1 cc、3cc、5cc、10cc、30 cc、1 盎司、1 磅。详细情况可以与当地的客户服务代表联系。

本产品对于皮肤敏感的人具有一定的致敏性，应避免皮肤直接接触。若不慎接触，请用肥皂和水冲洗，具体方法详见化学品安全说明书(MSDS, Material Safety Data Sheet)。

声明

上述的测量数据仅代表材料本身典型性能，不应当作为技术规格使用。KTS 认为这些数据的测量和操作方式是精确的，但不能为其精确性做出保证。KTS 建议用户在使用该产品前根据自己的操作方法和工艺条件判断其是否适合于特定的应用。KTS 的工程师也将会帮助用户更好的使用该产品，满足用户应用要求KTS从未授权任何人免除或改变上述条款